

## **АННОТАЦИЯ**

к рабочей программе дисциплины  
«Технологии микросварки и пайки в изделиях электронной техники»

**Направление подготовки** 15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ

**Профиль** «Технологии и оборудование сварочного производства»

**Квалификация выпускника** бакалавр

**Нормативный период обучения** 4 года / 4 года и 11 м.

**Форма обучения** очная / заочная

**Год начала подготовки** 2024

### **Цель изучения дисциплины:**

- изучение теоретических основ и особенностей формирования микросварных и паяных соединений в изделиях электронной техники, технологии и оборудования.

### **Задачи изучения дисциплины:**

- освоение способов микросварки и пайки;
- получение навыков разработки технологии микросварки и пайки на основе материала и конструкции изделия;
- изучение устройства, принципа работы и правил эксплуатации оборудования для микросварки и пайки.

### **Перечень формируемых компетенций:**

**ПК-3** Способен участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов сварки и родственных процессов в ходе подготовки производства новой продукции;

**ПК-4** Способен выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении сварных конструкций в машиностроении.

**Общая трудоемкость дисциплины:** 2 з.е.

**Форма итогового контроля по дисциплине:** Зачет